

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2024-001

成都硅宝科技股份有限公司 关于对外投资暨签订投资协议书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月14日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于对外投资的议案》，同意公司在上海市投资15,000万元设立硅宝科技(上海)有限公司（具体以主管机关最终登记为准）建设有机硅先进材料研发及产业化项目。

公司今日与上海市闵行区颛桥镇人民政府签订《投资协议书》，公司决定在上海市闵行区颛桥镇元江片区购置约16亩工业用地，投资15,000万元用于建设有机硅先进材料研究及产业化开发项目，项目包括硅宝上海研发中心、硅宝上海营销中心、5000吨/年电子及光学封装材料生产线等。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

- 名称：上海市闵行区颛桥镇人民政府
- 性质：地方政府机构
- 地址：闵行区颛桥镇颛盛路18号
- 关联关系：交易对方与公司不存在关联关系

三、投资项目基本情况

- 项目名称：有机硅先进材料研究及产业化开发项目
- 项目内容：硅宝上海研发中心、硅宝上海营销中心、5000吨/年电子及光学封装材料生产线等

- 3、项目主体：硅宝科技（上海）有限公司（待定）
- 4、投资规模：总投资15,000万元，其中固定资产投资不低于8000万元
- 5、占地面积：16亩（约），最终以依法出让方式取得的土地面积为准
- 6、建设周期：在交地后6个月内开工，24个月内竣工，36个月内投产，48个月内达产

7、项目地址：上海市闵行区颛桥镇元江片区61A-01A地块

8、资金来源：自有资金或自筹资金

具体以相关行政管理部门最终核准结果为准。

四、投资协议主要内容

甲方：上海市闵行区颛桥镇人民政府

乙方：成都硅宝科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》和其他有关规定，本着相互合作、共同发展的原则，乙方决定在上海市闵行区颛桥镇61A-01A地块投资15,000万元用于建设有机硅先进材料研究及产业化开发项目。

（一）意向用地概况

1、乙方选址于颛桥镇61A-01A地块，土地面积约16亩（地块位置及面积以项目实际情况和规划要求予以核定,以房屋测绘中心实测面积为准）。土地性质为工业用地，规划容积率2.0（地块相关数据以政府最终控制性详细规划为准）。

2、在满足本协议约定使用前提下，甲方同意向乙方提供上述土地，乙方将按照国家相关规定、通过招拍挂的方式取得该土地使用权。土地部门对上述地块的评估价格为上网挂牌价，最终中标价格为成交价格（最终竞拍价格）。

3、乙方保证在土地使用期内，经营范围符合闵行区和颛桥镇产业导向。

（二）项目建设进程

1、项目建设用地满足乙方需求条件后，乙方按本协议约定的时间启动建设工作。乙方将按照后续签订的《上海市国有建设用地使用权出让合同》及《建设工程施工合同》中有关条款约定，按时开工、竣工、投产、达产，并配合开展产业用地全生命周期管理。

2、双方一致同意，项目在交地后6个月内开工，24个月内竣工，36个月内投产，48个月内达产。

（三）甲方责任

1、支持乙方在区域内注册公司，甲方为乙方提供相应的政策指导、文件支持以及政府各部门间的协调。甲方根据有关扶持政策提供项目化扶持资金，积极协助乙方在满足政策条件下，享受闵行区产业、科技创新政策支持和综合服务。

2、甲方将协助乙方办理项目地块土地、规划、建设中的相关手续事宜。

3、在完成土地招拍挂、乙方支付完土地款项后，甲方应当在30个工作日内协助乙方取得土地所有权证。

4、甲方负责提供道路、通讯、排水、供水、排污、通电、通气等至选址地块相邻的规划道路，并负责将土地平整至自然标高（简称“七通一平”），甲方应当在乙方支付完土地款后30个工作日内促使本协议约定地块达到施工条件。若乙方对公用配套设施有特殊需求，甲方将协助乙方办理，费用由乙方承担。

5、甲方应向乙方提供工程建设时所用临时电力、给排水、通讯等在意向地块附近的接入口，乙方可以申请使用，费用由乙方承担。

6、在项目建设过程中，向乙方提供其他的必要协助。

（四）乙方责任

1、乙方承诺本协议签订三个月内在区域内注册公司，待项目建设完毕后，即将乙方注册地址更改至本协议所述出让地块，将此地块作为将来乙方的经营地。

2、乙方承诺项目总投资不低于15,000万元，其中固定资产投资不低于8000万元。

3、乙方承诺在经营期限内均在颛桥镇内注册并在闵行区税务局缴纳税金。

4、乙方取得本协议所述地块后，需向甲方缴纳土地出让价款的5%作为履约保证金。

5、乙方按照土地合同约定，不得改变土地使用用途和容积率，不得擅自改变产业项目类型。如未按土地使用用途进行开发的，乙方信息纳入企业信用档案，投资方以后不得申报项目评审及产业优惠政策。

6、保证房屋设计和建设符合颛桥镇低碳节能环保要求。

五、对外投资目的和对公司的影响

公司充分利用上海国际化优势，紧抓长三角一体化发展机遇，投资建设有机硅先进材料研究及产业化项目，符合公司围绕硅材料行业实施相关多元化发展战

略。公司设立上海研发中心，将充分利用上海国际化优势，吸引高端人才，完善研发体系，进一步提升公司技术研发实力；公司建设上海营销中心，将更好地服务长三角经济圈客户并辐射全球，增强公司在全球市场的影响力和竞争力；公司新建5000吨/年电子及光学封装材料生产线，将提升公司高端有机硅密封材料在电子封装、光学显示等领域的应用，解决有机硅行业高端材料技术难题。

公司将根据战略发展规划和项目实际情况分期实施，本项目的实施将为公司创造新的业绩增长点，助力公司持续快速发展，符合全体股东的利益。

六、风险提示

1、本项目资金来源为公司自有资金或自筹资金，具体以实际投资进度为准。公司将在不影响现金流健康的前提下，分期安排项目实施进度，实现经营效益最大化，确保该项目顺利实施。

2、本项目用地需通过招拍挂方式取得项目建设用地使用权，土地使用权能否取得和取得时间存在一定不确定性。

3、依据相关政策，本项目报批报建（立项、环评、安评、消防、验收等）、试生产申请、竣工验收等环节涉及的部门和审批程序较多，项目的前期相关审批准备工作尚在进行中，能否完成审批和审批时间具有一定不确定性。

4、本项目建设及投产过程中会面临各种不确定因素，未来市场情况的变化也会对项目进展造成不确定性影响，本项目存在经济效益达不到预期目标的风险。

公司将积极关注该投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、投资协议书。

特此公告！

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

2024年1月2日